タツモ株式会社　決算説明資料

2023年12月期第1四半期

2023年5月12日発表

タツモ株式会社

© 2020 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.

連結業績

TAZMO

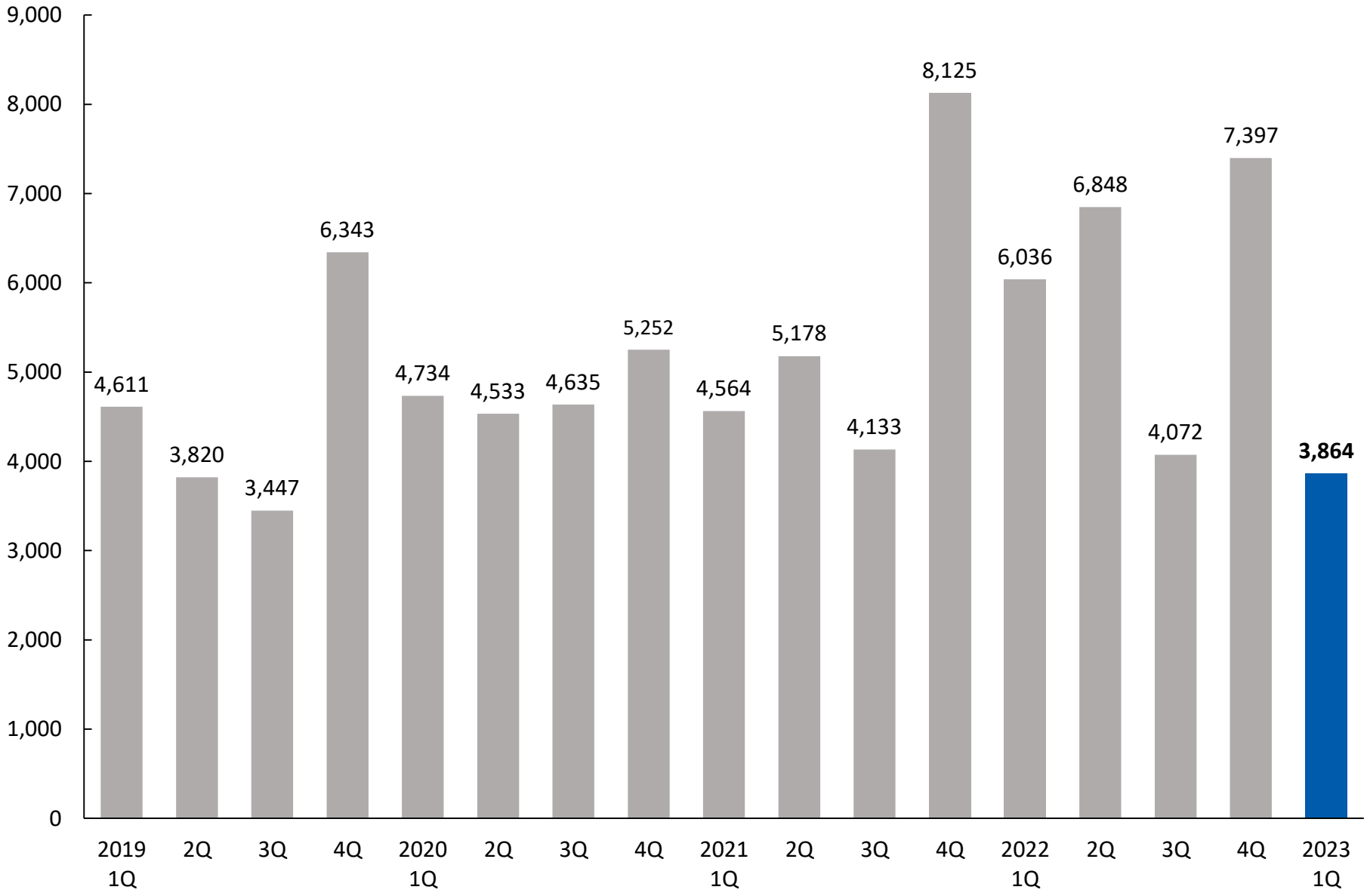
単位:百万円	’22年 1Q	’23年 1Q	売上比（%）	今期計画（通期）	達成率（%）
売上高	6,036	3,864	–	31,423	
売上総利益	1,692	983	25.4	–	–
販管費	1,046	1,120	29.0	–	–
営業利益	645	△136	–	3,118	–
経常利益	754	△231	–	3,087	–
親会社株主に帰属する四半期純利益	534	△219	–	2,109	–

売上高は前年同期比で36%減。営業利益も前年同期比781百万円減となった。

1Qは減収・減益の計画であったが、計画比で売上高1,039百万円、営業利益15百万円、経常利益101百万円、四半期純利益116百万円と、全て未達となった。

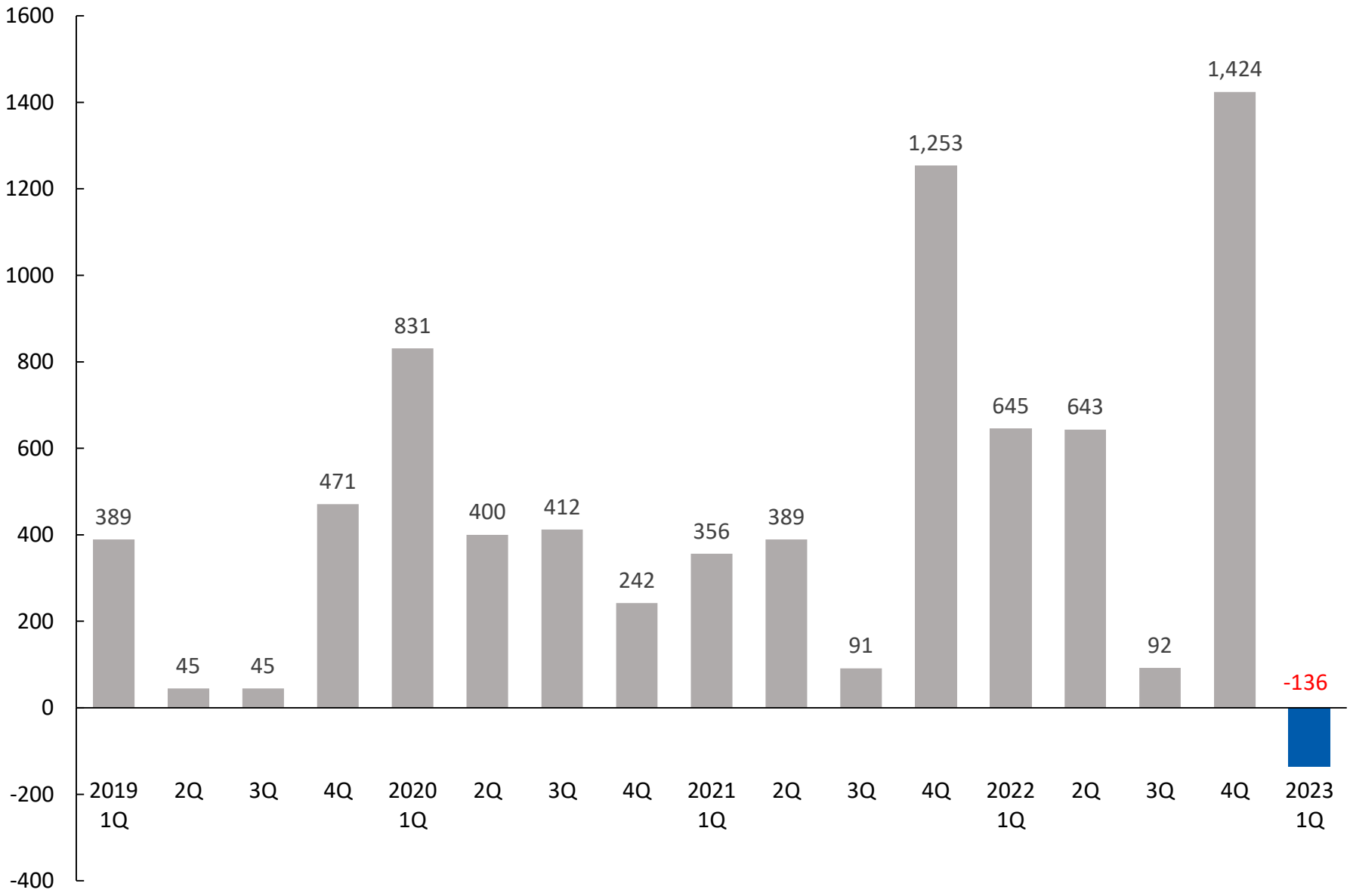
連結売上高推移

TAZMO



連結営業利益推移

TAZMO



連結貸借対照表

TAZMO

単位：百万円	‘22年12月期	‘23年1Q	増減
流動資産	31,905	34,471	2,565
有形固定資産	6,286	6,307	39
無形固定資産	198	188	△10
投資その他資産	1,025	1,056	31
総資産	39,397	42,022	2,625
流動負債	18,463	18,119	△343
固定負債	3,384	6,727	3,342
純資産	17,549	17,175	△373
自己資本比率	43.9%	40.2%	△3.7P

連結貸借対照表　主な増減

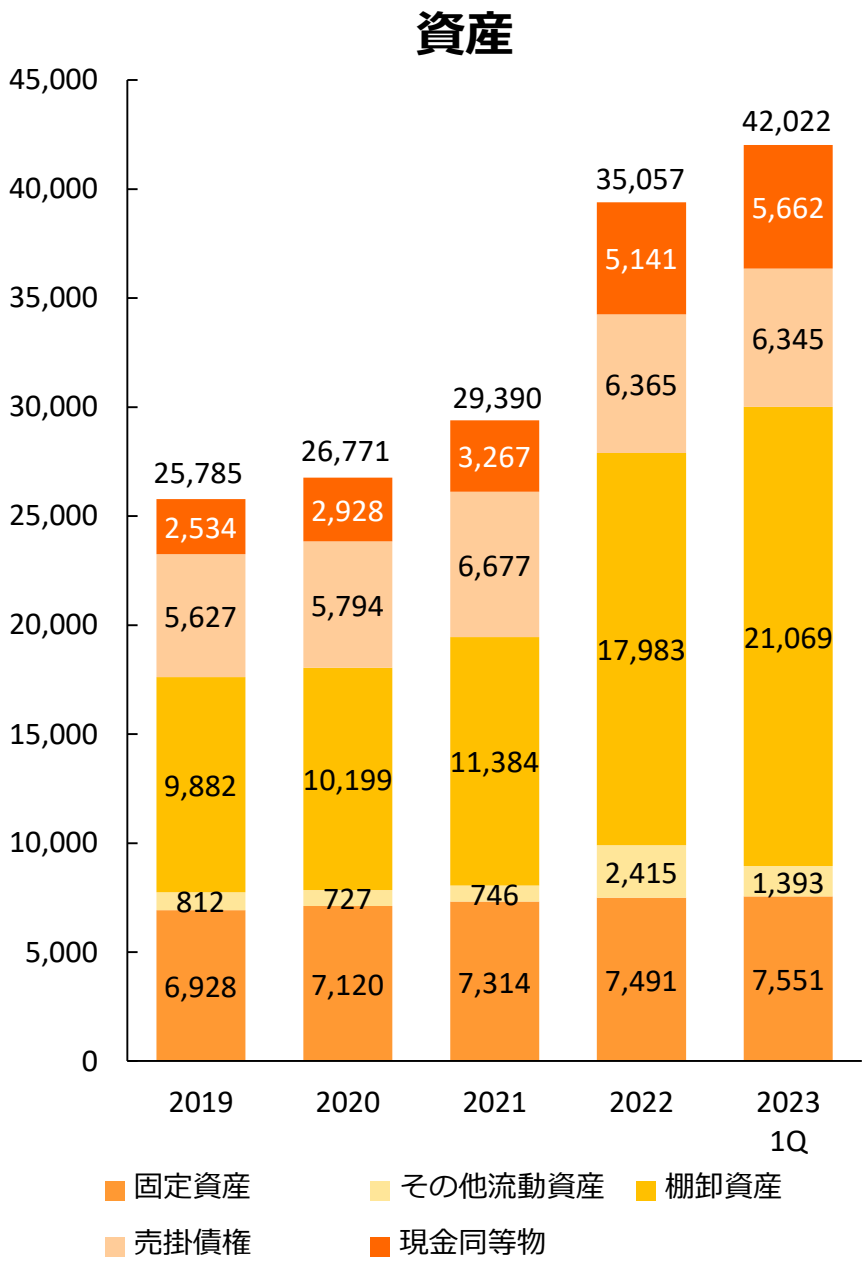
TAZMO

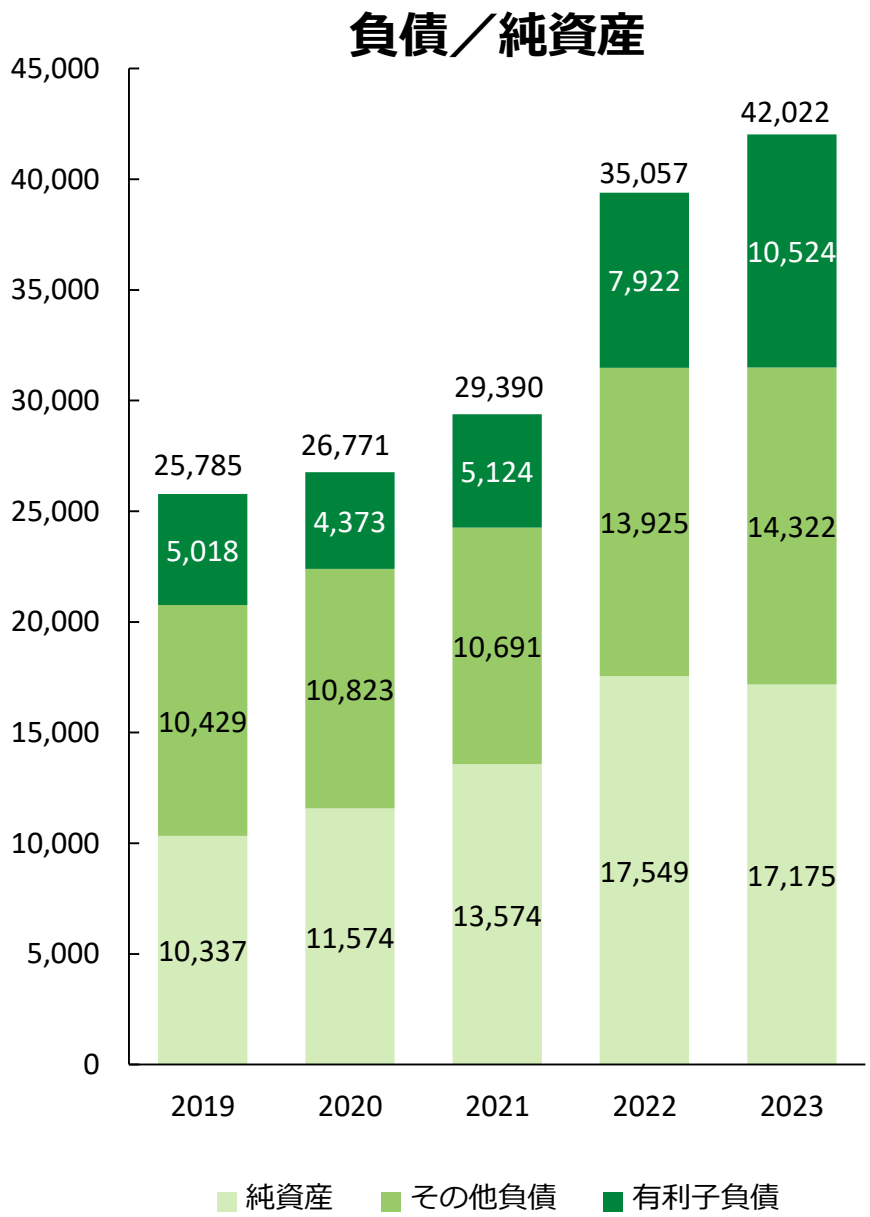
主な増減		
資産		
	‘23年1Q	前期末比
現金及び預金	5,662	520
受取手形及び売掛金	4,173	△322
電子記録債権	2,172	303
棚卸資産	21,069	3,086
負債		
	‘23年1Q	前期末比
短期借入金	4,513	△765
未払金	1,106	△478
契約負債	5,120	1,428
有償支給取引に係る負債	0	△576
長期借入金	6,010	3,367

資産・負債／純資産推移

TAZMO

単位：百万円





セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円	’22年 1Q	’23年 1Q	売上比（%）	今期計画（通期）	達成率（%）
売上高	**6,036**	**3,864**	**－**	**31,423**	**12.3**
プロセス機器事業	**4,842**	**2,879**	**74.5**	**22,974**	**12.5**
半導体装置	1,150	489	12.7	8,222	5.9
搬送機器	1,812	1,825	47.2	7,453	24.5
洗浄機	287	476	12.3	4,412	10.8
コーター	1,591	89	2.3	2,885	3.1
金型・樹脂成形事業	**404**	**357**	**9.3**	**2,156**	**16.6**
表面処理用機器事業	**789**	**627**	**16.2**	**6,292**	**10.0**

半導体装置：検収予定案件少なく、検収遅れも発生　前年同期比57.5%減。

搬送機器　：引続き受注好調、ベトナム子会社も好調に推移　前年同期比0.7%増

洗浄機　　：前年未検収分の売上計上も、今期分の検収遅れ発生　前年同期比65.8%増

コーター　：装置検収予定案件無く、前年同期比94.4%減

表面処理　：検収遅れ等により　前年同期比20.5%減

セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円	’22年 1Q	’23年 1Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
営業利益	**645**	**△136**	**－**	**3,118**	**－**
プロセス機器事業	580	△62	－	2,731	－
金型・樹脂成形事業	22	8	0.2	56	14.3
表面処理用機器事業	64	△58	－	330	－
セグメント間連結消去	△21	△24	－	－	－

プロセス機器事業　：計画より赤字幅縮小も黒字化できず　半導体装置の売上減少が影響大

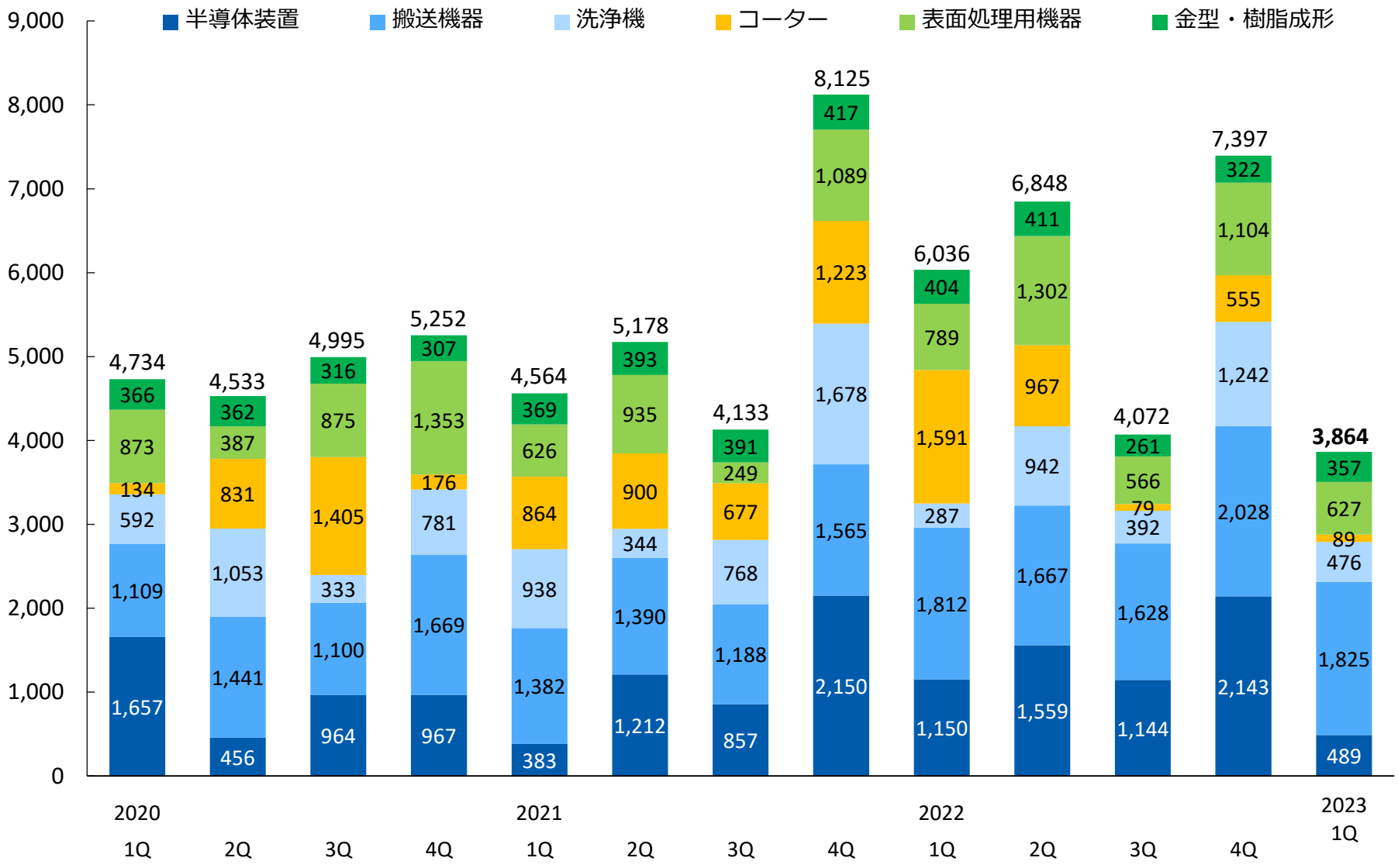
金型・樹脂成形事業：赤字計画から黒字化も　前年同期比63.6%減

表面処理用機器事業：利益率の悪い案件の売上が多く黒字化できず

セグメント別　売上高推移

TAZMO

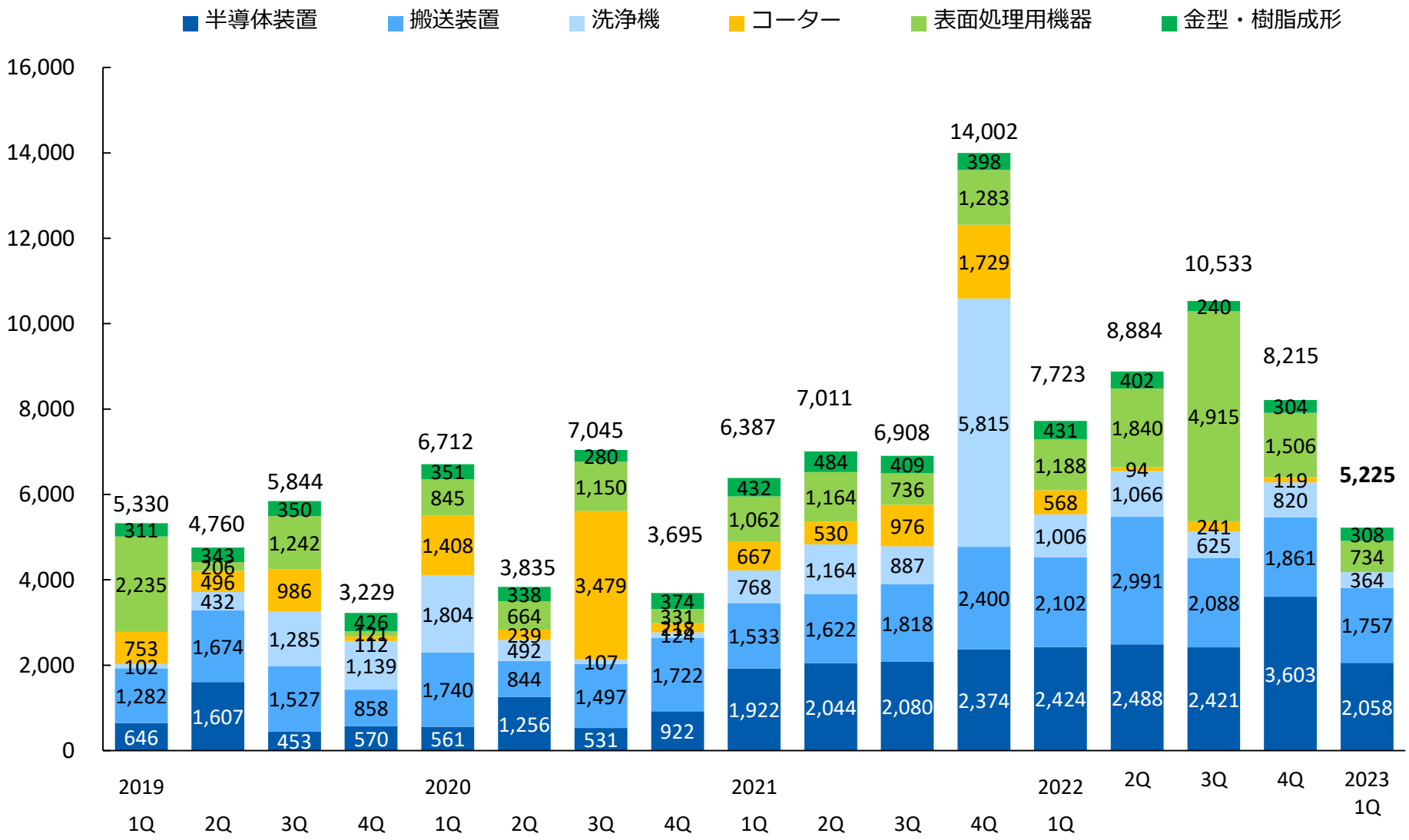
単位：百万円



セグメント別　受注高推移

TAZMO

単位：百万円



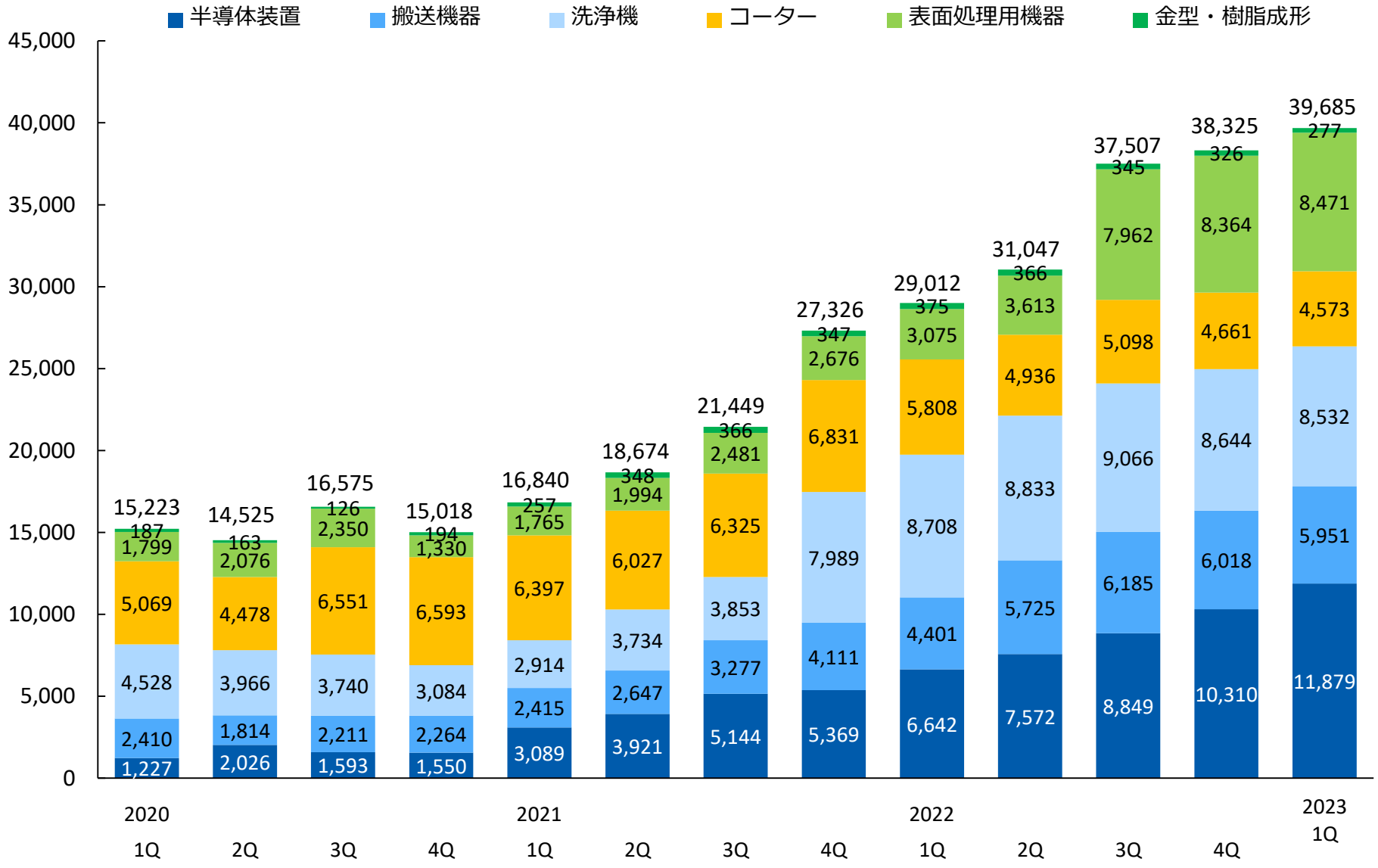
プロセス機器事業　：半導体装置及び搬送機器の受注良好。搬送装置で引合が弱まってきている。コーターでは装置案件の受注無し。

表面処理用機器事業：引合案件は増加しているが、納期調整で受注が確定しにくい

セグメント別　受注残高推移

TAZMO

単位：百万円



市場（顧客）の状況

TAZMO

工場建設の遅れ、他社装置入荷の遅れ、デバイス受注タイミングのズレ、生産量調整等、様々な要因により、検収のタイミングの遅延が発生している。部品納期や半導体業界の減速なども影響していると思われる。

半導体

パワー半導体及びそれ以外向けでも、納入後の立上げタイミングの調整を求められることが増えて来ており、検収のタイミングが遅くなっている。

受注については、昨年の平均レベルにはないものの安定しており、新規引き合いも継続的にある。

搬送

製造・検査工程は、引き続きキャパ一杯が続いている状況。

表面処理

生産キャパ一杯を継続中、旺盛な受注をうけ、受注残は拡大。

部品調達

全体的に部品の入手性は改善したが、一部の部品が未だ入手困難な状況にあり、製品出荷のボトルネックとなっている

会社概要

TAZMO

人としての優しさと卓越した想像力を基本に、
あくなき「挑戦」によって、豊かな未来社会の創造に貢献する

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	34億9,540万538円
発行済株式数	14,813,300株
株主数	4,589名（2022年12月31日現在）
従業員数	単体 364名/連結 1,105名（2022年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、 めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品 などの開発・製造・販売

沿革

TAZMO

1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
	半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
	ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

沿革

TAZMO

2009	第１０世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
	３Ｍ社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
	ﾛﾝｱﾝ省ﾛﾝﾊｳ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
2022	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
	公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
	中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

国内拠点・関連子会社

TAZMO

タツモ第1工場

タツモ第3工場

タツモ第5工場

クォークテクノロジー

プレテック

ファシリティ
出雲研究所

タツモ東京営業所

ファシリティ本社

タツモ本社

海外拠点

TAZMO

富莱得科技(東莞)有限公司

富莱得(香港)有限公司

龍雲阿普理夏电子科技有限公司

上海龍雲精密機械有限公司

龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司（※）

東莞

香港

上海

サンフランシスコ

TAZMO VIETNAM CO.,LTD.

ベトナム

台湾

TAZMO INC

FACILITY HANOI CO.,LTD.

龍雲亞普恩科技股份有限公司

（※）2022年７月15日付で龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を設立しました。

セグメント紹介

TAZMO

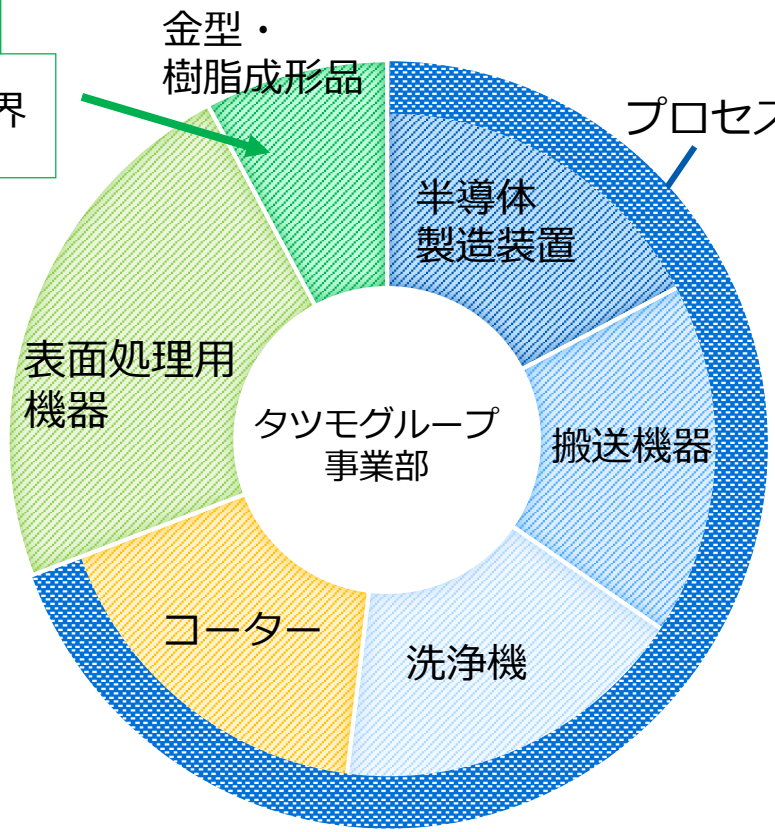
プレテック株式会社

金型・樹脂成形品業界

株式会社ファシリティ

PCB業界

※PCB：電子回路基盤



タツモ株式会社

半導体製造装置業界
FPD製造装置業界

※FPD：フラットパネルディスプレイ

半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

事業紹介

TAZMO

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、
シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを
仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売

搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットや
アライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した
製品等の開発・製造・販売

洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、
スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売

事業紹介

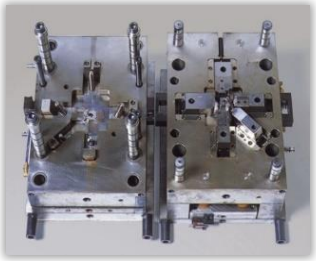
TAZMO

コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発･製造・販売

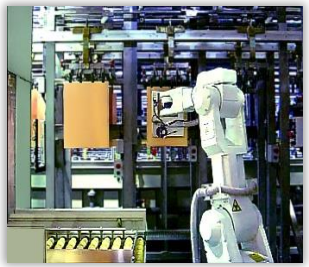
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使った
コネクター等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の
開発・製造・販売



注意事項

TAZMO

本資料の取扱上の注意

本資料は、2023年５月12日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社　経営企画室

TEL　086-239-5000
FAX　086-239-5100
Email　keiki@tazmo.co.jp

TAZMO

© 2020 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.